MICRO FLUID SYSTEM SUPPORTING UNIT AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

Publication number: JP2004174701 (A)Also published as:Publication date:2004-06-24JP3933058 (B2)

Inventor(s): KAWAZOE HIROSHI; EP1486455 (A1) NAKASO AKISHI; ARIGA EP1486455 (A4) SHIGEHARU + EP1486455 (B1)

SHIGEHARU + EP1486455 (B1)

Applicant(s): HITACHI CHEMICAL CO LTD US2005249637 (A1)

+ more >>

Classification:

- international: B01J19/00; B01L3/00; B81B1/00; B81C3/00; B81C99/00; B01J19/00;

B81C99/00; B01J19/00; B01L3/00; B81B1/00;

B81C3/00; B81C99/00; (IPC1-7): B01J19/00; B81B1/00;

B81C3/00

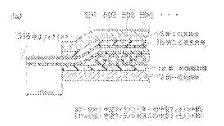
- European: B01J19/00R; B01L3/00C6M Application number: JP20030046414 20030224

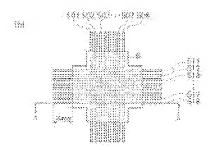
Priority number(s): JP20030046414 20030224;

JP20020048580 20020225; JP20020292978 20021004

Abstract of JP 2004174701 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a micro fluid system supporting unit that facilitates manufacturing and does not restrict the number of processes, or the amount of reaction or an analysis. SOLUTION: The micro fluid system supporting unit comprises: a first supporting element 2; a first adhesive layer 1a provided on a surface of the first supporting element 2; a first hollow filament group made of a plurality of hollow filaments 501 to 508 laid on a surface of the first adhesive layer 1a so as to have any shape; a second hollow filament group made of a plurality of hollow filaments 511 to 518 laid in a direction orthogonal to the first hollow filament group; a second adhesive layer 1b provided on a surface of the second hollow filament group; and a second supporting element 6 provided on a surface of the second adhesive layer 1b. The first and second filament groups structure a flow passage layer.; COPYRIGHT: (C)2004,JPO





Data supplied from the **espacenet** database — Worldwide

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-174701 (P2004-174701A)

(43) 公開日 平成16年6月24日(2004.6.24)

(51) Int.C1. ⁷	FI	テーマコード(参考)
B81B 1/00	B81B 1/00	4GO75
B O 1 19/00	BOLL 19/00 3.2.1	

B81C 3/00 B81C 3/00

審査請求 未請求 請求項の数 16 OL (全 20 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2003-46414 (P2003-46414) 平成15年2月24日 (2003.2.24)	(71) 出願人	000004455 日立化成工業株式会社
(31) 優先権主張番号	特願2002-48580 (P2002-48580)		東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
(32) 優先日	平成14年2月25日 (2002. 2. 25)	(74) 代理人	100083806
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(13) (02)	弁理士 三好 秀和
(31) 優先権主張番号	特願2002-292978 (P2002-292978)	(74) 代理人	100068342
, ,	·	((4) ((年))	弁理士 三好 保男
(32) 優先日	平成14年10月4日 (2002.10.4)	(- 1) 15 1	
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(74)代理人	100100712
			弁理士 岩▲崎▼ 幸邦
		(74) 代理人	100087365
			弁理士 栗原 彰
		(74) 代理人	100100929
			弁理士 川又 澄雄
		(74) 代理人	100095500
		-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,	弁理士 伊藤 正和
			最終頁に続く

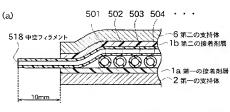
(54) 【発明の名称】マイクロ流体システム用支持ユニット及びその製造方法

(57)【要約】

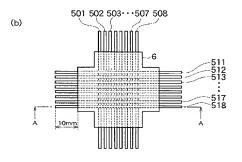
【課題】製造が容易、且つ反応や分析の工程数や量を制限しないマイクロ流体システム用支持ユニットを提供する。

【解決手段】第一の支持体2と、この第一の支持体2の表面に設けられた第一の接着削層1点と、第一の接着削層1点の表面に任意の形状に敷設された複数の中空フィラメント501~508からなる第一の中空フィラメント群と、この第一の中空フィラメント群に直交する方向に敷設された複数の中空フィラメント群と、この第二の中空フィラメント群の表面に設けられた第二の接着削層1b2、第二の接着削層1bの表面に設けられた第二の支持体6とを備える。第一及び第2二の中空フィラメント群は、流路層を構成する。

【選択図】 図1



501~508:中空フィラメント(第一の中空フィラメント群) 511~518:中空フィラメント(第二の中空フィラメント群)



【特許請求の範囲】

【請求項1】

第一の支持体と、

該第一の支持体の表面に設けられた第一の接着削層と、

該 第一の接着 剤 層の表面に任意の形状に敷設されたマイクロ流体システムの流路 層として機能する中空フィラメント

とを備えることを特徴とするマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項2】

第一の支持体と、

該第一の支持体の表面に設けられた第一の接着剤層と、

該 第一の接着削層の表面に任意の形状に敷設され、 されざれがマイクロ流体システムの複数の流路層として機能する複数の中空フィラメントからなる第一の中空フィラメント群とを備えることを特徴とするマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項3】

前記第一の中空フィラメント群の表面に設けられた第二の接着剤層と、

該第二の接着削層の表面に設けられた第二の支持体

とを更に備えることを特徴とする請求項2に記載のマイクロ流体システム用支持ユニット

【請求項4】

前記第一の中空フィラメント群に互いに交差する方向に敷設され、前記マイクロ流体システムの他の複数の流路層として機能する、複数の中空フィラメントからなる第二の中空フィラメント群を更に備えることを特徴とする請求項2又は3に記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項5】

前記複数の中空フィラメントの一部が、前記第一の支持体から露出していることを特徴とする請求項2~4のいずれか1項に記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項6】

前記複数の中空フィラメントの少なくとも1本の一部に金属膜が形成されていることを特徴とする請求項2~5のいずれが1項に記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項7】

前記複数の中空フィラメントの少なくとも1本の一部が、光透過部を構えることを特徴とする請求項2~6のいずれか1項に記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項8】

第一の支持体と、

該第一の支持体の表面に設けられた第一の接着剤層と、

該第一の接着削層の表面に敷設された複数の中空フィラメントと、

前記第一の接着削層と前記中空フィラメント上に設けられた第二の接着削層と、

該第二の接着剤層の表面に設けられた第二の支持体と、

前記第一の接着削層と前記第二の接着削層に設けられ、前記中空フィラメントの経路を接続する中継部

とを備えることを特徴とするマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項9】

前記中継部は前記第二の支持体の一部を含むことを特徴とする請求項8に記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項10】

第一の支持体の表面に、第一の接着削層を形成するステップと、

該第一の接着剤層の表面に中空フィラメントを敷設するステップ

とを含むことを特徴とするマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法。

【請求項11】

第一の支持体の表面に、第一の接着剂層を形成するステップと、

10

20

30

40

50

20

30

40

50

該 第一の接着削層の表面に複数の中空フィラメントからなる第一の中空フィラメント群を 敷設するステップ

とを含むことを特徴とするマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法。

【請求項12】

前記第一の接着削層を形成するステップと、前記第一の中空フィラメント群を敷設するステップとの間に、

前記第一の接着削層の表面の中空フィラメントを露出させる箇所に離形層を設けるステップと、

前記第一の支持体にスリットを設けるステップ

とを更に含み、前記第一の中空フィラメント群は前記一対の離形層の双方の表面に接して 敷設されることを特徴とする請求項11に記載のマイクロ流体システム用支持ユニットの 製造方法。

【請求項13】

前記第一の中空フィラメント群を敷設するステップの後、前記第一の中空フィラメント群に交差する方向に複数の中空フィラメントからなる第二の中空フィラメント群を敷設するステップを更に含むことを特徴とする請求項11又は12に記載のマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法。

【請求項14】

前記第一の中空フィラメント群を敷設するステップの後、前記第一の中空フィラメント群の表面に、第二の接着剤層を形成するステップと、

該 第 二 の 接 着 剤 層 の 表 面 に 第 二 の 支 持 体 を 接 着 す る ス テ ッ プ

とを更に含むことを特徴とする請求項11又は12に記載のマイクロ流体システム用支持 ユニットの製造方法。

【請求項15】

第一の支持体の表面に、第一の接着削層を形成するステップと、

前記第一の接着削層の表面に複数の中空フィラメントを敷設するステップと、前記第一の接着削層と前記中空フィラメント上に第二の接着削層を形成するステップと、

前記第一の接着削層及び前記第二の接着削層に中継部を形成するステップと、

前記第二の接着削層の表面に第二の支持体を接着するステップ

とを含むことを特徴とするマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法。

【請求項16】

前記第一の接着削層及び前記第二の接着削層に前記中継部を形成するステップは、更に前記第二の支持体も前記中継部の一部となるように形成することを含むことを特徴とする請求項15に記載のマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、支持体上に中空フィラメントを所定の形状に敷設固定したマイクロ流体システム用支持ユニット及びその製造方法に関する。

[00002]

【従来の技術】

化学や生化学の分野ではマイクロ電子機械システム(Micro Electro Mechanical System: MEMS)技術を応用した反応系や分析装置の小型化に関する研究が進められている。従来の研究開発では、構成要素の一つとなるマイクロモータ、マイクロポンプの単一機能を有するマイクロ化した機械要素(マイクロマシン)がある(例えば非特許文献 1、2参照)

[0003]

目的の化学反応や化学分析を行うためには、マイクロマシンなどの各種部品を複数組み合わせてシステム化する必要がある。一般にせれらのシステムの完成形は、マイクロリアクター(Micro Reactor System)、マイクロ化学分析システム(Micro Total Analysis Sys

30

50

tem: μTAS)などと呼称されている。通常、マイクロマシンは半導体製造プロセスを適用してシリコンチップ上に形成する。複数の要素を一つのチップに形成(集積)し、システム化することは、原理的には可能であり、その取り組みも実際行われている(例えば、非特許文献多参照)。しかし、その作製プロセスは複雑であり、量産レベルでこれを製造することは困難と予想されている。複数のマイクロマシンなどを接続して流体回路(システム)を形成する方法として、シリコン基板の所定の位置にエッチング等で溝を形成し流路とするチップ型基板(ナノリアクター)が提案されている。上記の集積化する方法より製造ははるかに容易というメリットがある。しかし、流路断面積が小さく流体と溝側面との界面抵抗が大きく、その流路長は最大でmm単位といったところが現状であり、実際に行われる合成反応や化学分析では、反応や分析のステップ数や量が制限されてしまう。

[0004]

【非特許文献1】

庄子、「化学工業」、2001年4月、第52巻、第4号、P.45-55

[0005]

【非特許文献2】

前田、「エレクトロニクス実装学会誌」、2002年1月、第5巻、第1号、P.25-26

[00006]

【非特許文献3】

伊永, 「日本学術会議50周年記念環境工学連合講演論文集」, 1999年, 第14号, 20P.25-32

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、その作製プロセスは複雑であり、量産レベルでこれを製造することは困難と予想されている。そのため近年では、複数のマイクロマシンなどを接続して流体回路を形成する方法として、シリコン基板の所定の位置にエッチング等で溝を形成し流路とするチップ型基板が提案されている。この方法には上記の集積化する方法よりチップ型基板の製造が、はるかに容易というメリットがある。しかし、その一方でこの方法では、流路断面積が小さく流体と溝側面との界面抵抗が大きく、その流路長は最大でmm単位が現状であり、実際に行われる合成反応や化学分析では、反応や分析のステップ数や量が制限されてしまう問題がある。

[0008]

本発明は、上記課題を解決するためになされたものである。即ち、本発明の目的は、製造が容易で、且つ反応や分析のステップ数や量を制限しないcm単位の長い距離のマイクロ流体システム用支持ユニットを提供することである。

[0009]

本発明の他の目的は、複雑な流体回路であっても場所を要しない小型マイクロ流体システム用支持ユニットを提供することである。

本発明の更に他の目的は、複雑な流体回路を形成できるマイクロ流体システム用支持ユニ 40 ットの製造方法を提供することである。

[0011]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明の第1の特徴は、(イ)第一の支持体と、(ロ)この第一の支持体の表面に設けられた第一の接着削層と、(八)この第一の接着削層の表面に任意の形状に敷設された中空フィラメントとを備え、(二)この第一の接着削層の表面に任意の形状に敷設されたマイクロ流体システムの流路層として機能する中空フィラメントとを備えるマイクロ流体システム用支持ユニットであることを要旨とする。

[0012]

本発明の第1の特徴においては、この中空フィラメンに交差する形で更に中空フィラメン

20

30

40

50

トを立体的に敷設することが出来るため、精度が良く、製造が容易で、且つ反応や分析のステップ数や量を制限しないcm単位の長い距離のマイクロ流体システム用支持ユニットを提供することが出来る。更に、本発明の第1の特徴によれば、複雑な流体回路であっても場所を要しない小型マイクロ流体システム用支持ユニットを提供することが出来るため、マイクロ流体システム自体のコンパクト化を図ることも出来る。

[0013]

又、本発明の第2の特徴は、(イ)第一の支持体と、(ロ) この第一の支持体の表面に設けられた第一の接着削層と、(八)第一の接着削層の表面に任意の形状に敷設され、それでれがマイクロ流体システムの複数の流路層として機能する複数の中空フィラメントがらなる第一の中空フィラメント群とを備えるマイクロ流体システム用支持ユニットであることを要旨とする。

[0014]

本発明の第2の特徴においては、複数の中空フィラメントからなる第一の中空フィラメント群に、これらに交差する複数の中空フィラメントからなる第二の中空フィラメント群を立体的に敷設することが出来るため、精度が良く、製造が容易で、且つ反応や分析のステップ数や量を制限しないとm単位の長い距離のマイクロ流体システム用支持ユニットを提供することが出来る。更に本発明の第1の特徴によれば、複雑な流体回路であっても場所を要しない小型マイクロ流体システム用支持ユニットを提供することが出来るため、マイクロ流体システム自体のコンパクト化を図ることも出来る。

[0015]

本発明の第3の特徴は、(イ)第一の支持体の表面に、第一の接着削層を形成するステップと、(ロ)この第一の接着削層の表面に中空フィラメントを敷設するステップとを含む マイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法であることを要旨とする。

[0016]

本発明の第3の特徴に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法は、第1の特徴で説明したマイクロ流体システム用支持ユニットを用いる製造方法である。本発明の第3の特徴によれば、複雑な流体回路を形成できる小型のマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法を提供することが出来る。

[0017]

本発明の第4の特徴は、(イ)第一の支持体の表面に、第一の接着削層を形成するステップと、(ロ)この第一の接着削層の表面に複数の中空フィラメントがらなる第一の中空フィラメント群を敷設するステップとを含むマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法であることを要旨とする。

[0018]

本発明の第4の特徴に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法は、第2の特徴で説明したマイクロ流体システム用支持ユニットを用いる製造方法である。本発明の第4の特徴によれば、複雑な流体回路を形成できる小型のマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法を提供することが出来る。

- [0019]
- 【発明の実施の形態】

図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号で表している。ただし、図面は模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なる。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を照らし合わせて判断するべきものである。又、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。

[0020]

(第1の実施の形態)

(マイクロ流体システム用支持ユニット)

図1に示すように、本発明の第1の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユニットは、第一の支持体2と、この第一の支持体2の表面に設けられた第一の接着削層1のと

、第一の接着削層1のの表面に任意の形状に敷設された複数の中空フィラメント501、502、503、・・・・・、508からなる第一の中空フィラメント群と、この第一の中空フィラメント群に交差する方向に敷設された複数の中空フィラメント511、512、518、・・・・・、518からなる第二の中空フィラメント群と、この第二の中空フィラメント群の表面に設けられた第二の接着削層16と、第二の接着削層16の表面に設けられた第二の支持体6とを備える。複数の中空フィラメント501、502、503、・・・・・、508からなる第一の中空フィラメント群、及び複数の中空フィラメント511、512、513、・・・・・・・518からなる第二の中空フィラメント群は、それでれ本発明の第1の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの薬液の流路層を構成している。

[0021]

複数の中空フィラメント501~508及び511~518の内径及び外径は目的に応じ て選択すれば良いが、ミリリットル(mL)~マイクロリットル(μL)単位の流体を流 中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 及び 5 1 1 ~ 5 1 8 を作製する場合は、ポリイミド(P I)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリエーテルイミド(PEI)、ポリ フェニレンサルファイド(PPS)、4フッ化エチレン・パーフルオロアルコキシエチレ ン共重合体(PFA)などの材質が特に適している。 40.05mm以下の内径にすると 、 中空 フィ ラ メ ン ト 5 0 1 ~ 5 0 8 及 び 5 1 1 ~ 5 1 8 の 内 壁 面 と 流 体 と の 界 面 抵 抗 の 影 響 が 無 視 で き な く な る 。 一 方 、 φ 0. 5 m m よ リ 大 き い 内 径 で は 流 体 を 連 続 的 に 流 す 友 め に は 高 圧 が 瓜 要 と な リ 他 の 部 品 へ の 負 担 が 増 え 、 又 流 体 中 へ の 気 泡 の 混 入 な ど が 生 じ て し ま う 。 複 数 の 中 空 フ ィ ラ メ ン ト 5 0 1 ~ 5 0 8 か ら な 3 第 一 の 中 空 フ ィ ラ メ ン ト 群 、 及 ぴ 複数の中空フィラメント511~518からなる第二の中空フィラメント群に流している 流体に化学反応を生じさせる場合は、中空フィラメント501~508. 511~518 は耐薬品性を備えるものが良い。又、中空フィラメント501~508.511~518 に流している流体に光を照射し、光化学反応を生じさせたり、分光分析をする場合は、中 空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 . 5 1 1 ~ 5 1 8 に光透過性があると良い。光透過率は目 的に応じた値で良いが、目的波長において80%以上であることが好ましく、更に、90 % 以上あれば最適である。即ち、図9 (a) に示すように、所定箇所の第二の支持体 6、 第 二 の 接 着 剤 層 1 b 、 及 ぴ 中 空 フ ィ ラ メ ン ト 5 8 が 透 明 で あ 3 こ と 、 又 は 中 空 フ ィ ラ メ ン ト58が露出し、且つ少なくともこの箇所の中空フィラメント58が透明であると良い。 [0022]

中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 . 5 1 1 ~ 5 1 8 を第一の支持体 2 に固定することは、フリーの状態にすることと比較して、周囲の温度・電場・磁場など様々な環境を制御し易いという優れたメリットがある。このことは、化学反応や化学分析を行う際に有利であり、特にマイクロ化された反応系及び分析系においては不可欠である。又、部品とのアライメントが容易で接続し易い、且つ多数の中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 . 5 1 1 ~ 5 1 8 をコンパクトに収容できるという利点もある。

[0023]

又、化学分析を行う場合、複数の中空フィラメント501~508、511~518を有していることが作業効率を高める点で良い。この場合、第一の中空フィラメント群を構成する複数の中空フィラメント501~508は、同時に分析を開始した時、ほぼ同時に分析結果が得られなければならないという観点から、互いに等長であることが求められる。同様に、第二の中空フィラメント群を構成する複数の中空フィラメント511~518も等長であることが求められる。つまり、試料の流入部から流出部まで外部から受けるエネルギー量が均一であり、更に他の中空フィラメントが受けるエネルギー量ともほとんど差がないことが重要である。この様な観点から、中空フィラメント501~508、511~518だと枚以上の支持体間に挟まれていることが好ましい。

[0024]

50

40

10

20

30

20

30

40

50

又、第一の中空フィラメント群を構成する複数の中空フィラメント501~508及び第二の中空フィラメント群を構成する複数の中空フィラメント511~518は、それぞれ互いに等間隔に配列されていることが好ましい。又、第一の中空フィラメント群を構成する複数の中空フィラメント501~508及び第二の中空フィラメント群を構成する複数の中空フィラメント511~518の管の厚みは均一である方が良い。

複数の中空フィラメント501~508、511~518は、市販の各種材質のチュープを使用することが出来、目的に応じて任意の材質のものを選択すれば良い。例えば、ポリリール樹脂(PVC)、ポリ塩化ピニリデン樹脂、ポリ酢酸ピニル樹脂、ポリピニル カールコール樹脂(PVA)、ポリスチレン樹脂(PB)、スチレン・アクリロニトリル・プタジエン共重合体(ABS)、ポリエチレン樹脂(PE)、エチレン・酢酸ピニル共産合体(EVA)、ポリプロピレン樹脂(PP)、ポリ4ーメチルペンテン(TPX)、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、PEEK、PI、PEI、PPS、酢酸セルロース、四フッ化エチレン・オレン共重合体(ETFE)、3フッ化塩化エチレン、アドA、4フッ化エチレン・エチレン共重合体(ETFE)、3フッ化塩にエチレン(PCTFE)、オリアミド樹脂(ナイロン)、ポリアセタール(POM)、ポリフェニレンテレフタレート(PPO)、ポリカーボネート樹脂(PC)、ポリウレタン樹脂、ポリエステル

エラストマ、ポリオレフィン樹脂、シリコーン樹脂、ポリイミド樹脂などの有機材質や、

[0026]

ガラス、石英、カーボンなどの無機材質がある。

第一の支持体2の材質、形状、サイズなどは目的に応じて選定すれば良い。又第一の支持 体2の板厚、フィルム厚の適正な範囲は目的や求められる機能によって異なる。例えば、 第 一 の 支 持 体 2 に 電 気 絶 縁 性 を 求 め る 場 合 は 、 プ リ ン ト 配 線 板 な ど に 用 い ち れ て い る エ ポ キシ樹脂板やポリイミド樹脂板や、フレキシブル配線板に用いられているデュポン社製の カプトンフィルムに代表されるようなポリイミドフィルムや東レ社製のルミラーフィルム に代表されるようなPETフィルムを選定する。第一の支持体2の板厚(フィルム厚)は 厚い方が好ましく、特には0.05mm以上であることが望ましい。又、第一の支持体2 に放熱性を求める場合は、アルミ(Al)板、銅(Cu)板、ステンレス板、チタン(T i) 板 な ど の 金 属 製 の 板 を 選 定 す る 。 第 一 の 支 持 体 2 の 板 厚 は 更 に 厚 い 方 が 好 ま し く 、 特 には 0 . 5 mm以上であることが望ましい。又、第一の支持体 2 に光透過性を求める場合 は、ガラス、石英板など透明無機材料の板や、ポリカーボネートやアクリルなど透明有機 材料の板やフィルムを選定する。第一の支持体2の板厚(フィルム厚)は薄い方が好まし く、特には 0 . 5 mm以下であることが望ましい。更に、第一の支持体 2 の表面に鋼等の 金属パターンをエッチングやめっきで形成したいわやるフレキシブル回路基板やプリント 回路基板を用いても良い。このことで、マイクロマシン、発熱素子、圧電素子、温度・圧 カ・歪み・振動・電圧・磁界など各種のセンサーや抵抗・コンデンサ・コイル・トランジ スタやICなどの電子部品、更に半導体レーザ(LD)、発光ダイオード(LED)、及 び フ ォ ト ダ イ オ ー ド 〔 P D 〕 な ど の 光 部 品 な ど 、 様 々 な 部 品 や 素 子 を 実 装 す る 端 子 や 回 路 を形成でき、システム化が容易になる。

[0027]

第一の支持体2の表面に形成する第一の接着削層1 a、は、感圧性や感光性を備える接着削が好ましい。これらの材料は、圧力や光などを印加することで粘着性や接着性を発現させるので、中空フィラメント(中空キャピラリ)を機械的に敷設する場合に適する。感圧性接着削では、高分子量合成ゴムやシリコーン樹脂系の接着削が適する。高分子量合成ゴムやシリコーン樹脂系の接着削が適する。高分子量合成ゴムやシリコーン樹脂系の接着削が適する。高分子量合成ゴムロ技術の接着削が適する。高分子量合成ゴムロ技術のでスタネックスMML-120の様なポリイソプチレンや、日本セオン社製のニポールN1432等のアクリロニトリルプタジエンゴムや、デュポン社製のハイパロン20の様なクロルスルホン化ポリエチレン等を用いることが出来る。この場合は、これら材料を溶削に溶解して第一の支持体2に直接塗布乾燥して第一の接着削層1aを形成することが出来る。更に、必要に応じてこれら材料に架

20

30

40

50

橋 削 を 配 合 す る こ と も 出 来 る 。 又 、 日 東 電 工 社 製 No. 5 0 0 や ス リ ー 工 ム 社 製 の A - 1 0 、 A - 2 0 、 A - 3 0 等のアクリル樹脂系の両面粘着テープ等も使用できる。シリコーン 樹 脂 系 の 接 着 剤 と し て は 、 高 分 子 量 の ポ リ ジ メ チ ル シ ロ キ サ ン ヌ は ポ リ メ チ ル フ ェ ニ ル シ ロ キ サ ン が ら な り 末 端 に シ ラ ノ ー ル 基 を 有 し た シ リ コ ー ン プ ム と 、 メ チ ル シ リ コ ー ン レ ジ ン ヌは メチ ル フ ェ ニ ル シ リ コ ー ン と い っ た シ リ コ ー ン レ ジ ン と を 主 成 分 と し た シ リ コ ー ン 接着剤が適している。凝集力を制御するため各種の架橋を行っても良い。例えば、シラン の 付 加 反 応 、 ア ル コ キ シ 縮 合 反 応 、 ア セ ト キ シ 縮 合 反 応 、 過 酸 化 物 な ど に よ る ラ ジ カ ル 反 応などにより架橋を行すことが出来る。この様な接着剤として市販のものでは、YR32 86(GE東芝シリコーン株式会社製、商品名)やTSR1521(GE東芝シリコーン 株式会社製、商品名)、DKQ9-9009(ダウコーニング社製、商品名)などがある 。感光性接着剤としては、例えば、プリント基板のエッチングレジストとして使用されて いるドライフィルムレジストやソルダーレジストインクやプリント基板の感光性ピルドア ップ材等が適用できる。具体的には、日立化成工業(株)製のH-K440やチバガイギ ー 社 製 のプ ロピ マ ー 等 が あ る 。 特 に 、 ピ ル ド ア ッ プ 配 線 板 用 途 と し て 提 供 さ れ て い る フ ォ トピア材料は、プリント配線板の製造工程やはんだによる部品実装工程にも耐えることが 出来る。この様な材料としては、光によって架橋可能な官能基を有した共重合体或りは単 量体を含んだ組成物及び/又は光の他に熱で架橋可能な官能基と熱重合開始剤を混合した 組成物であれば何れも使用可能である。

[0028]

第 一 の 接 着 剤 層 1 α と し て は 、 エ ポ キ シ 樹 脂 、 ブ ロ ム 化 エ ポ キ シ 樹 脂 、 ゴ ム 変 性 エ ポ キ シ 樹脂、 ゴム 分 散 工 ポ キ シ 樹 脂 等 の 脂 環 式 工 ポ キ シ 樹 脂 又 は ピ ス フ ェ ノ ー ル ー A 系 工 ポ キ シ 樹脂及びこれらエポキシ樹脂の酸変性物などが挙げられる。特に光照射を行って光硬化を 行 う 場 合 に は こ れ ら 工 ポ キ シ 樹 脂 と 不 飽 和 酸 と の 変 性 物 が 好 ま し い 。 不 飽 和 酸 と し て は 無 水マレイン酸 無水物、テトラヒドロフタル酸 無水物、イタコン酸 無水物、アクリル酸、メ タ ク リ ル 酸 等 が 学 げ ら れ そ 。 こ れ ら は エ ポ キ シ 樹 脂 の エ ポ キ シ 基 に 対 し 等 量 若 し く は 等 量 以下の配合比率で不飽和カルポン酸を反応させることによって得られる。このほかにもメ ル樹脂の組み合わせ等も好ましい適用例の一つである。他には可とう性付与材の使用も好 適な組み合わせであり、その例としてはブタジェンアクリロニトリルゴム、天然ゴム、ア ク リ ル ゴ ム 、 S B R 、 カ ル ボ ン 酸 変 性 ブ タ ジ ェ ン ア ク リ ロ ニ ト リ ル ゴ ム 、 カ ル ボ ン 酸 変 性 ア ク リ ル ゴ ム 、 架 橋 N B R 粒 子 、 カ ル ボ ン 酸 変 性 架 橋 N B R 粒 子 等 が 学 げ ら れ る 。 こ の 様 な 種 々 の 樹 脂 成 分 を 加 え る こ と で 光 硬 化 性 、 熱 硬 化 性 と り う 基 本 性 能 を 保 持 し た ま ま 硬 化 物に色々な性質を付与することが可能になる。例えばエポキシ樹脂やフェノール樹脂との 組 み 合 わ せ に よ っ て 硬 化 物 に 良 好 な 電 気 絶 縁 性 を 付 与 す る こ と が 可 能 に な る 。 ゴ ム 成 分 を 配 合 し 友 時 に は 硬 化 物 に 強 靭 な 性 質 を 与 え る と 共 に 、 酸 化 性 薬 液 に よ る 表 面 処 理 に よ っ て 硬 化 物 表 面 の 粗 化 を 簡 単 に 行 う こ と が 可 能 に な る 。 又 、 通 常 使 用 さ れ る 添 加 剤 〔 重 合 安 定 削、レベリング削、顔料、染料等)を添加しても良い。又フィラーを配合することもなん ら差し支えない。フィラーとしてはシリカ、溶融シリカ、タルク、アルミナ、水和アルミ ナ 、 硫 酸 パ リ ウ ム 、 水 酸 化 カ ル シ ウ ム 、 エ ー ロ ジ ル 、 炭 酸 カ ル シ ウ ム 等 の 無 機 微 粒 子 、 粉 末 状 エ ポ キ シ 樹 脂 、 粉 末 状 ポ リ イ ミ ド 粒 子 等 の 有 機 微 粒 子 、 粉 末 状 ポ リ テ ト ラ フ ロ ロ エ チ レン粒子等が挙げられる。これらのフィラーには予めカップリング処理を施してあっても 良い。これらの分散はニーダー、ボールミル、ピーズミル、3本ロール等既知の混練方法 によって 達成 され る。 この 様 な 感 光 性 樹 脂 の 形 成 方 法 は 、 液 状 の 樹 脂 を 口 ー ル コ ー ト 、 カ ーテンコート、ディプコート等の方法で塗布する方式や、絶縁樹脂をキャリアフィルム上 でフィルム化してラミネートで張合わせる方式を用いることが出来る。具体的には、日立 化成工業(株)製のフォトピアフィルムBF-8000等がある。

[0029]

第二の支持体 6 は、第一の支持体 2 で示した各種の材料が使用できる。更に第二の支持体 6 と複数の中空フィラメント 5 1 1 ~ 5 1 8 からなる第二の中空フィラメント群との間に、第二の接着削層 1 b が挿入することで、複数の中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 からな

20

30

40

50

る第一の中空フィラメント群、及び複数の中空フィラメント 5 1 1 ~ 5 1 8 からなる第二の中空フィラメント群を保護する作用が一層増すので好ましい。第二の支持体 6 として網目状又は多孔性のフィルムを選択すれば、ラミネート時の気泡の抱き込みといった不具合が生じにくくなる。この網目状フィルム又は織物としては、東京スクリーン社製のポリエステルメッシュTB-70等があり、多孔性のフィルムとしては、セラニーズ社製のジュラがードやダイセル化学工業社製のセルガード 2 4 0 0 等がある。

[0030]

第二の接着剤層1bは、第一の接着剤層1丸で示した各種の材料が使用できる。

[0081]

(マイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法)

次に、本発明の第1の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法について図2~図8を用いて説明する。

[0032]

(イ)まず、図2に示すように、第一の支持体2の表面に、第一の支持体2と同一形状で、ほぼ同一サイズの第一の接着削層1 a を形成する。そして、図3に示すように、第一の接着削層1 a の表面の周辺部に均等に4つの矩形の離形層3 a 、3 b 、3 c 、3 d を形成する。この様な離形層3 a 、3 b 、3 c 、3 d を第一の接着削層1 a の表面に形成するには、第一の接着削層1 a の表面の所定の箇所に、市販の離形削を予め塗布する方法や、離形フィルムを貼り付ける方法がある。次に、この第一の支持体2にカッター等でスリット4 a 、4 b 、4 c 、4 d は、図3(b)に示すように、例えば、4つの離形層3 a 、3 b 、3 c 、3 d のそれぞれの内側の辺の近傍の位置に形成する。

[0033]

(ロ)次に、図4に示すように、第一の接着削層1のが形成された第一の支持体2の表面にあいて、離形層3 b から離形層3 d に向かう垂直方向に、複数の中空フィラメント群を敷設する。この際には、図示では、図っているが、図5 (の)と同様なNC布線機6 1 を用いる(この様な布線機として9 3 4 6 号公報に開示されている を置けある。又、特公平5 0 9 9 1 0 号公報に開示されている を置けある。又、特公平5 0 9 8 6 2 2 号公報に開示されている装置は、荷重の印加とレーサ光の駅射が可能である。)。NC布線機6 1 は、数値制御され超音波振動と荷重の出力制御可能であり、NC布線機6 1 を用いることにより、複数の中空フィラメント5 0 1 ~ 5 0 8 からなる第一の中空フィラメント群に荷重及び超音波による振動をかける。

[0034]

(八)次に、図5に示すように、複数の中空フィラメント511~518からなる第二の中空フィラメント群を、すでに敷設されたすの中空フィラメント群に交差するように、離形層30から離野層30から前離ででで、から11~5118から方向なる第一の中空フィラメント群に交差する。)に示すようにNC布線機61を開いる。一つ数でで、で、変数の中空フィラメント511~518からなる第二の中空フィラメント511~518からなる第二の中空フィラメント511~518からなる第二の中空フィラメント511~518からなる第二の中空フィラメント511~518からなる第二の中空フィラメント511~518からなる第二の中空フィラメント511~518が正する。第一の中空オント群とででフィラメント511~518が正する。第一の中空フィラメント群との中空フィラメントが出来る。

20

30

40

50

[0035]

(二) 次に、図 6 に示すように、すでに敷 設された複数の中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 か 5 な 3 第 一 の 中 空 フ ィ ラ メ ン ト 群 、 及 び 複 数 の 中 空 フ ィ ラ メ ン ト 5 1 1 ~ 5 1 8 か 5 なる第二の中空フィラメント群を覆すように、第一の支持体2の同一形状で、ほぼ同一サ の第二の支持体6を用意し、第二の接着剤層1bの上に、第二の支持体6を接着(ラミネ ート)する。第二の支持体6をラミネートするには各種方法が考えられる。この時に第二 の支持体 6 が網目状又は多孔性のフィルムの場合は、僅かの圧力をかけることで界面に抱 き 込 ま れ る 空 気 等 も な く 保 護 フ ィ ル ム を 第 二 の 接 着 剤 層 1 b に 密 着 す る こ と が 出 来 る 。 し かし、 第二の支持体 6 が均一なフィルムの場合は、 残存気泡は避けられない。この場合は 、高圧でプレスする方法も考えられるが、中空フィラメント501~508、511~5 1 8 に 大 き な 力 が 加 わ り 中 空 部 分 の 変 形 が 生 じ る 。 更 に 、 第 一 の 中 空 フ ィ ラ メ ン ト 群 と 第 ニ の 中 空 フ ィ ラ メ ン ト 群 と の 交 差 部 で 局 所 的 に 大 き な 力 が か か り 破 損 し て し ま う 等 の 問 題 がある。この様な場合は、真空ラミネート装置を用いて、第二の支持体6が第二の接着剤 層1bに密着する前に真空状態にし、その後低圧で圧着することで、界面に抱き込まれる 空 気 も な く 中 空 フ ィ ラ メ ン ト 5 0 1 ~ 5 0 8 . 5 1 1 ~ 5 1 8 に 大 き な 応 力 が 残 存 せ ず 破 損もないため好ましい。

[0036]

(ホ) その後、図7(b)の点線で示す所望の形状の切断線7に沿って、加工切断する。 第 二 の 支 持 体 6 を ラ ミ ネ ー ト し 友 後 に 、 所 望 の 形 状 に マ イ ク 口 流 体 シ ス テ ム 用 支 持 ユ ニ ッ トを加工する方法としては、カッターによる切断や、所望の形に予め作製した金属製の刃 型を押し当てて切断加工する等の方法がある。しかし、カッターでは自動化に難があり、 刃 型 は 治 工 具 の 作 製 に 手 間 が か か る た め 、 N C 駆 動 の レ ー ザ 加 工 機 の 方 が デ ー タ の 準 備 の みで作業できるため好ましい。又、レーザ加工機においても、切断専用の出力の大きな加 工機よりも、プリント基板用の小径穴あけ用途のレーザ穴あけ機が好ましい。プリント基 板 用 の レ ー ザ 穴 あ け 機 は 、 単 位 時 間 当 り の 工 ネ ル ギ ー 出 力 が 大 き く 同 ー の 場 所 を 複数 の シ ョット数で穴あけし、穴径の半分程度づつ移動させてやく方式であり、レーザの焼け焦げ が非常に少なく好ましい。切断線7は、図7(b)に示すように、予めスリット4α、4 b. 4 c. 4 d を入れておいた位置4a に重なる様に加工切断する。図7(a)に示すよ アに、予めスリット4の、4b、4c、4dを入れておくことにより、中空フィラメント 5 1 8 の端部近傍において、第一の接着削層1 0 と第二の接着削層1 b が、自動的に剥離 してくる。図示を省略しているが、他の中空フィラメント501~508、511、51 2. 5 1 3. ・・・・・. 5 1 7 の端部も同様に、第一の接着剤層1 など第二の接着剤層 1bとが自動的に剥離する。第一の接着剤層1aに複数の中空フィラメント501~50 8 からなる第一の中空フィラメント群、及び複数の中空フィラメント5 1 1 ~ 5 1 8 から 持体 6 を 張 合 わ せ た 構 造 で は 、 複 数 の 中 空 フィ ラ メン ト 5 0 1 ~ 5 0 8 . 5 1 1 ~ 5 1 8 の端部を露出する工程が煩雑となる。このため、不要となって最後に除去される部分と、 第 一 の 支 持 体 2 と し て 残 存 す る 部 分 の 境 界 線 と な る と こ ろ に 予 め ス リ ッ ト 4 瓜 . 4 b . 4 c、4 dを設けておけば、中空フィラメント501~508.511~518の端部を露 出する処理が容易になる。

[0037]

(へ)図7(b)の点線で示す切断線7に沿って切断加工した後、中空フィラメント501~508の端部付近に配置された離形層3b及び離形層3d、更に、中空フィラメント511~518の端部付近に配置された離形層3c及び離形層3cを除去すれば、図1に示すマイクロ流体システム用支持ユニットが完成する。

[0088]

上記のように、不要となって最後に除去される第一の支持体2の端部の表面に、図4に示すように、離形層3の、3b、3c、3dを設けておけば、マイクロ流体システム用支持ユニットの端部から複数の中空フィラメント501~508からなる第一の中空フィラメ

20

30

40

50

ント群、及び複数の中空フィラメント511~518からなる第二の中空フィラメント群をされずれ取り出す処理を更に容易に行うことが出来る。しかし、中空フィラメント501~508、511~518は、露出する部分の長さについて注意する必要がある。中空フィラメント501~508、511~518の露出しない部分は固定されており、中空フィラメント501~508、511~518中の流体に対し、温度、流速分布、泳動速度分布及び印加電圧等の因子を制御し易い。一方、中空フィラメント501~508、511~518の露出する部分は、固定されず自由な状態であるので、前述の各因子を制御することは難しいからである。又、中空フィラメント501~508、511~518の露出する部分は、取り扱い不注意等による折損を生じ易くなる。したがって、露出させる長さは可能な限り短くすることが重要であり、少なくとも露出させる部分の長さより短くすることが望ましい。

[0039]

[0040]

(第2の実施の形態)

本発明の第2の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユニットは、図8に示すように、第一の接着削層10、第二の接着削層16、及び第二の支持体6を壁部とし、第一の支持体2を底部とする中継部8を備える点が図1に示した本発明の第1の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユニットと異なり、他は本発明の第1の実施の形態と同様であるので重複した記載は省略する。

[0041]

中継部8は、図8に示すように、第一の接着削層1のと第二の接着削層16の間から中空フィラメント58を露出する構造になっている。露出した中空フィラメント58は、流体を排出する。中継部8は、排出された流体を混合、又は分岐させる。中継部8の形状やサイズは流体の流量に応じて決めれば良い。例えば、2~3本の内径 φ200μmの中空フィラメント58を保持する第一の接着削層16の厚さの合計が200μmの場合、中継部8はφ2mm~φ7mm程度の円柱形状で良い。

[0042]

中継部8となる所定箇所の第一の接着削層1 a、第二の接着削層1 b、及び中空フィラメント58の除去加工にはレーザ加工が好ましい。特に、除去する部分の体積、即ち中継部8の体積がmm³単位以下の小さな場合、レーザ加工が好適である。レーザ加工に用いるレーザは、炭酸ガスレーザ、YAGレーザ、エキシマレーザ等であり、第一の接着削層1a、第二の接着削層1 b、及び中空フィラメント58の材質に応じて選択すれば良い。尚、中継部8をレーザで加工する場合は、第一の支持体2の表面にレーザのストッパとなる銅やアルミといった金属薄膜を形成したものを用いると良い。中継部8の体積がcm³単位以上の大きい範囲を除去する場合は、ドリル等の機械加工を適用しても良い。機械加工の場合、切削時に生じる樹脂くずを取り除くデスミア処理が追加される。

20

30

40

50

[0043]

第二の支持体6を中継部8の一部とする方法としては、第二の支持体6を第二の接着削層1 b を接着した後、第二の支持体6に中継部8の一部となる形状に加工を施す工程がある。この場合は、注射針等のニードルで第二の支持体6を突き刺す方法等が適する。

[0044]

又、他の方法としては、第一の接着削層1 & と第二の接着削層1 & に中継部8を形成する際、同時に第二の支持体6にも中継部8の一部となる形状に加工を施す方法がある。この場合は、前述のレーザで一括して加工をする方法等が適する。

[0045]

更に、他の方法としては、第二の支持体6に予め中継部8の一部となる形状に加工を施しておき、これを第二の接着削層1bに接着する方法がある。第二の支持体6に施す加工法としてはドリル加工、パンチング、及びレーザ加工等がある。

[0046]

本発明の第2の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユニットによれば、中継部8を構えることによって、中空フィラメント58を流れる流体を混合又は分岐させることが出来る。更に、第二の支持体6を中継部8の一部にすることで、中継部8を開いた構造に出来るので、外部から中継部に新たな流体を注入する、又は中継部8にある流体を外部に取り出すことが出来る。

[0047]

(実施例1)

2 に示すように、第一の接着削層1のとして、厚さ250μmで、室温で粘着性であるス リーエム 社 製 V B H A - 1 0 フィ ルム を ロ ー ル ラ ミ ネ ー ト す る 。 こ の 第 一 の 支 持 体 2 の 所望の位置に、図3に示すように、離形層3の、3b、3c、3dとして片面離形紙を離 形 面 が 接 着 剤 面 が 密 着 す る 様 に 設 け る 。 更 に 、 図 4 に 示 す よ う に 、 カ ッ タ ー で 、 第 ー の 支 持体2の所望の位置に、スリット4の、4b、4c、4dを入れる。これに図5(の)に 示すように、超音波振動と荷重の出力制御が可能でNC制御でX-Yテーブルを可動でき るNC布線機61を用い、仁礼工業株式会社の高機能エンプラチューブ(材質:PEEK 、内径 0 . 2 m m 、外形 0 . 4 m m) 6 2 からなる中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 . 5 1 1 ~ 5 1 8 を敷設する。敷設する中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 . 5 1 1 ~ 5 1 8 に は、 荷 重 8 0 9 と 周 波 数 3 0 k H z の 超 音 波 に よ 3 振 動 を か け 3 。 図 5 (b) に 示 す よ う に、中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 . 5 1 1 ~ 5 1 8 の敷設は、半径 5 m m の円弧状に 行い、交差する部分も設ける。その交差する部分の近傍では、荷重と超音波振動を止める こ と と す る 。 第 二 の 支 持 体 6 と し て 、 デ ュ ポ ン 社 製 カ プ ト ン 8 0 0 H の 表 面 に ス リ ー エ ム 社製VBH A-10フィルムをロールラミネートしたものを用い、図6に示すように、 | 真 空 ラ ミ ネ ー ト で 複 数 の 中 空 フ ィ ラ メ ン ト 5 1 1 ~ 5 1 8 か ら な る 第 二 の 中 空 フ ィ ラ メ ン ト群を敷設した表面にラミネートする。その後の外形加工では、プリント基板用の小径穴 あけ用途のレーが穴あけ機を用い、パルス幅5mS、ショット数4ショットでφ0.2m mの穴を0.1mm間隔で移動させて、図7に示す所望の切断線7に沿って、幅広の十字 の形に加工切断する。この時、 0. 4mmピッチで8本まとめてフラットケーブル状にな る部分で予めスリット4α、4b、4c、4dを入れておいた部分と重なる様に加工する 。 その後、 中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 . 5 1 1 ~ 5 1 8 の 端 部 付 近 の 第 一 の 支 持 体 2 に離形層3a.3b.3c.3dを貼り付けてある部分は容易に除去できる。そして、 8 本の全長 2 0 cmの中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 からなる第一の中空フィラメント 群、 及 ぴ 8 本 の 全 長 2 0 c m の 中 空 フ ィ ラ メ ン ト 5 1 1 ~ 5 1 8 か ら な る 第 二 の 中 空 フ ィ ラメント群を、 それぞれの 端部の 1 0 m m の長さを露出させた形状でマイクロ 流体システ ム用支持ユニットを作製する。敷設部分全般、特に交差する部分で中空フィラメントの破

[0048]

損はない。

こ の 結 果 、 複数 の 中 空 フ ィ ラ メ ン ト 5 0 1 ~ 5 0 8 か ら な る 第 一 の 中 空 フ ィ ラ メ ン ト 群 、

20

30

40

50

及び複数の中空フィラメント 5 1 1 ~ 5 1 8 からなる第二の中空フィラメント群で形成した流路の位置ばらつきは、設計図面に対し、± 1 0 μ m 从内に収まる。マイクロ流体システム用支持ユニットを温度調節器内に入れ、80℃に保ち、液状の着色インクを一方の端から流入し、流出までの時間をストップウォッチ等の計測機器で計測した場合、8 本ともほぼ同じタイミング(± 1 秒以下)で他端から流出する。

[0049]

(実施例2)

1 0 0 μ m の 第 一 の 接 着 剤 層 1 α と し て 非 粘 着 型 感 圧 接 着 剤 ダ ウ コ ー ニ ン グ ア ジ ア 社 製 の S 9 0 0 9 をロールラミネートする。又、図 3 に示すように、中空フィラメントの端部付 近の表面で不要となる部分に、粘着性のないフィルムとして片面離形紙からなる離形層る α、3 b、3 c、3 d を離形面が接着剤面に密着する様に設ける。これに、図4及び図5 に示すように、超音波振動と荷重の出力制御が可能でNC制御でX-Yテープルを可動で き る N C 布 線 機 6 1 を 用 い 、 八 ギ テ ッ ク 社 の ガ ラ ス チ ュ ー ブ E S G ー 2 〔 内 径 O . 8 m m 外 径 1 mm)を敷 設 す る 。 敷 設 す る 中 空 フ ィ ラ メ ン ト 5 0 1 ~ 5 0 8 、 5 1 1 ~ 5 1 8 に は、荷重100分と周波数20kHzの超音波による振動をかける。図5(b)に示すよ すに、中空フィラメント501~508、511~518の敷設は、半径10mmの円弧 状に行い、交差する部分も設ける。その交差する部分の近傍では、荷重と超音波振動を止 めることとする。第二の支持体6には、フィルム支持体と同じデュポン社製カプトン20 O H を用い、図 6 に示すように、真空ラミネートを用いて中空フィラメント 5 O 1 ~ 5 O 8 、 5 1 1 ~ 5 1 8 を 施 設 し た 支 持 ユ ニ ッ ト 上 に ラ ミ ネ ー ト す る 。 そ の 際 、 流 入 部 、 流 出 部 、 及 び 交 差 部 の 中 空 フ ィ ラ メ ン ト 5 0 1 ~ 5 0 8 、 5 1 1 ~ 5 1 8 近 傍 に 温 度 測 定 用 の 熱 電 対 を 埋 め 込 む 。 そ の 後 の 、 図 7 に 示 す 外 形 加 エ で は 、 プ リ ン ト 基 板 用 の 外 形 加 エ 機 を 用いて所望の形に切断する。この時、1mmピッチで12本まとめてフラットケープル状 になる部分で予めスリット4の、4b、4c、4dを入れておりた部分と重なる様に加工 する。 その後、 複数の中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 、 5 1 1 ~ 5 1 8 の端部付近の支 持体に粘着性のないフィルムを貼り付けてある部分は容易に除去でき、12本の全長40 c m の 中 空 フィ ラ メ ン ト 5 0 1 ~ 5 0 8 、 5 1 1 ~ 5 1 8 を 5 0 m m の 長 さ を 露 出 さ せ た 形状のマイクロ流体システム用支持ユニットを作製できる。中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 08、511~518で形成した流路の位置ばらつきは設計図面に対し、±20μm以内 に収まる。敷設部分全般、特に交差配線部分で中空フィラメント501~508、511 ~ 5 1 8 の破損はない。

[0050]

共立電子産業製のフィルムヒートドTH-40をアルミ板裏面の全面に貼り付け90℃に設定する。約20℃の水を一方の端から流入し、他端から流出した水の温度を測定したところ、88±1℃である。又、流入部、流出部、及び交差部の各温度は89±0.5℃であり、精度良い温度制御が可能である。

[0051]

(実施例3)

図8に示すように、第一の支持体2に厚さ18μmの銅を表面に有する銅張積層板(板厚0.2mm)を用い、やの表面に、第一の接着削層10及び第二の接着削層16として、室温で非粘着性接着削であるダウコーニングアジア社製89009(厚さ200μm)をロールラミネートする。これに超音波振動と荷重の出力制御が可能でNC制御でXーソテーブルを可動できるマルチワイヤ用布線機を用い、仁礼工業株式会社の高機能エンプラチューブ(材質:PEEK、内径0.2mm、外形0.4mm)を敷設する。敷設する中空フィラメント58には、荷重80分と周波数30kHzの超音波による振動をかける。中空フィラメント58の敷設は、半径5mmの円弧状に行い、交差する部分も設ける。やの交差部の近傍では、荷重と超音波振動を止めることとする。第二の支持体6として、デュポン社製カプトン200Hの表面にダウコーニングアジア社製89009(厚さ200μm)をロールラミネートしたものを用い、真空ラミネートで中空フィラメント58を敷設

20

30

40

50

した表面にラミネートする。

[0052]

その後、中継部8となる箇所の第二の支持体6、第一の接着削層1の、第二の接着削層1 b、及び中空フィラメント58に対して、プリント基板用の小径穴あけ用途のレーザ穴あ け機を用いパルス幅5mS、ショット数を4ショットでφ0.2mmの穴をあける。その 後、ルーターで外形加工し、複数の流路が接続した中継部8を有するマイクロ流体システ ム用支持ユニットを作製できる。

[0053]

(その他の実施の形態)

本発明は上記の形態によって記載したが、この開示の一部をなす部分及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなるう。

[0054]

例えば、図9(α)に示すように、マイクロ流体システム用支持ユニットの一部に貫通孔を設け、カム付きモータなどで中空フィラメント58の一部に時間周期的な力を加えこの箇所の中空フィラメントを変形させ、この箇所にある流体を移動させて、脈動流を生じさせるマイクロポンプ、若しくはマイクロバルプのような使い方をする場合は、中空フィラメント58に弾性があると良い。特に、中空フィラメント58は、ヤング率で10⁸ MPa 以下であることが好ましい。

[0055]

又、図9(b)に示すように、露出した中空フィラメント58の一部に金属膜59を形成し、電圧などを印加するための端子を形成することが出来る。この場合、Cu、AI、ニッケル(Ni)、クロム(Cr)、金(Au)、等を単層、或いは多層化してめっきや蒸着などで形成すると良い。

[0056]

又、マイクロ流体システム用支持ユニットは、図8(α). 図8(b)に示すように、開口部である中継部8を備えていたが、中継部8が流体の混合又は分岐のみを行う場合、図10に示すように、第二の支持体6を除去加工しないで閉ざした構造にしても良い。

[0057]

更に、第一の中空フィラメント群と第二の中空フィラメント群は必ずしも90度に直交している必要はなく、交差していれば良い。したがって、例えば、第一及び第二の中空フィラメント群だりでなく、更に第三の中空フィラメント群を敷設することも可能である。

[0058]

ー方、中空フィラメントは必ずしも交差させる必要はなく、図11及び図12に示すように、一方向に走行する複数の中空フィラメント501~508からなる第一の中空フィラメント群のみから構成しても良い。

[0059]

又、図13に示すように、湾曲を描く複数の中空フィラメント511~518を敷設して も良い。

[0060]

尚、中空フィラメントは、必ずしも複数敷設されていなくても良く、即ち中空フィラメントは単数であっても良い。

[0061]

【発明の効果】

本発明によれば、製造が容易で、且つ反応や分析の工程数や量を制限しないcm単位の長い距離のマイクロ流体システム用支持ユニットを提供することが出来る。

[0062]

この結果、本発明によれば、精度が良く、且つ製造ばらっきが少なり流体回路(マイクロ流体システム)を提供することが出来る。更に、立体的に複数の中空フィラメントからなる第一の中空フィラメント群とこれに直交する複数の中空フィラメントからなる第二の中

空 フィ ラ メント 群 を 敷 設 で き る こ と か ら 複 雑 な 流 体 回 路 で あっ て も 小 型 の マ イ ク ロ 流 体 シ ステムを提供することが出来る。

[0063]

又 、 本 発 明 に よ れ ば 、 中 空 フ ィ ラ メ ン ト を 配 列 し 流 体 の 流 路 と し た マ イ ク 口 流 体 シ ス テ ム 用支持ユニットと、そのようなマイクロ流体システム用支持ユニットを精度良くかつ製造 ばらつきが少なく製造する方法を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1(a)は、本発明の第1の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユ : ット の 断 面 図 で 、 図 1 (b) は 、 A - A 線 矢 印 方 向 か ら 見 友 断 面 図 が 図 1 (a) に 対 応 する平面図である。

【図2】本発明の第1の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方 法を説明する工程断面図(その1)である。

【 図 3 】 図 3 (a.) は 、 本 発 明 の 第 1 の 実 施 の 形 態 に 係 3 マ イ ク 口 流 体 シ ス テ ム 用 支 持 ユ ニットの 製造 方 法 を 説 明 す る 工 程 断 面 図 (せ の 2) で 、 図 3 (b) は 、 A - A 線 矢 印 方 向 から見た断面図が図る(の)に対応する平面図である。

【 図 4 】 図 4 (α) は 、 本 発 明 の 第 1 の 実 施 の 形 態 に 係 3 マ イ ク ロ 流 体 シ ス テ ム 用 支 持 ユ ニットの 製 造 方 法 を 説 明 す る 工 程 断 面 図 (せ の 8) で 、 図 4 (b) は 、 A - A 線 矢 印 方 向 から見た断面図が図4(の)に対応する平面図である。

【図5】図5(a)は、本発明の第1の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユ ニットの 製 造 方 法 を 説 明 す る 工 程 断 面 図 (せ の 4) で 、 図 5 (b) は 、 A - A 線 矢 印 方 向 から見た断面図が図5(な)に対応する平面図である。

【図6】図6(a)は、本発明の第1の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユ ニット の 製 造 方 法 を 説 明 す る 工 程 断 面 図 (そ の 5) で 、 図 6 (b) は 、 A - A 線 矢 印 方 向 から見た断面図が図6(の)に対応する平面図である。

【 図 7 】 図 7 (α) は 、 本 発 明 の 第 1 の 実 施 の 形 態 に 係 3 マ イ ク ロ 流 体 シ ス テ ム 用 支 持 ユ ニットの 製造 方 法 を 説 明 す る 工 程 断 面 図 (せ の 6) で 、 図 7 (b) は 、 A - A 線 矢 印 方 向 から見た断面図が図7(a)に対応する平面図である。

【図8】図8(α)は、本発明の第2の実施の形態に係る中継部を備えるマイク口流体シ ステム用支持ユニットの為 図で、図8(b)は、図8(α)のA-A線方向の断面図で ある。

【 図 9 】 本 発 明 の そ の 他 の 実 施 の 形 態 に 係 る マ イ ク 口 流 体 シ ス テ ム 用 支 持 ユ ニ ッ ト 用 中 空 フィラメントの構造を説明する鳥 図である。

【 図 1 0 】 本 発 明 の そ の 他 の 実 施 の 形 態 に 係 る 中 継 部 を 備 え る マ イ ク ロ 流 体 シ ス テ ム 用 支 持ユニットの断面図である。

【図11】図11(a)は、図11(c)に示す本発明の更に他の実施の形態に係るマイ ク 口 流 体 シ ス テ ム 用 支 持 ユ ニ ッ ト の 平 面 図 の A - A 線 矢 印 方 向 か ら 見 友 断 面 図 、 図 1 1 (b)は、図11(c)に示す平面図のB-B線矢印方向から見た断面図である。

【 図 1 2 】 図 1 1 に 示 し 友 本 発 明 の せ の 他 の 実 施 の 形 態 に 係 る マ イ ク ロ 流 体 シ ス テ ム 用 支 持ユニットの鳥 図である。

【 図 1 3 】 本 発 明 の そ の 他 の 実 施 の 形 態 に 係 る マ イ ク 口 流 体 シ ス テ ム 用 支 持 ユ ニ ッ ト の 変 形例を示す鳥 図である。

【符号の説明】

- 1 a 第一の接着削層
- 1 b 第二の接着剤層
- 2 第一の支持体
- 3 a . 3 b . 3 c . 3 d 離形層
- 4a, 4b, 4c, 4d スリット
- 第二の支持体
- 7 切断線
- 中継部

20

10

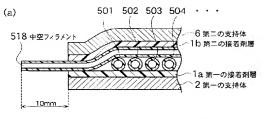
30

40

50

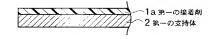
- 58,501~508,511~518 中空フィラメント
- 5 9 金属膜
- NC布線機 6 1

【図1】

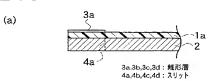


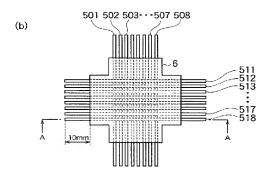
501~508:中空フィラメント(第一の中空フィラメント群) 511~518:中空フィラメント(第二の中空フィラメント群)

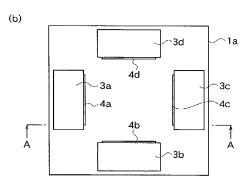




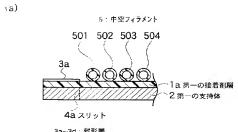




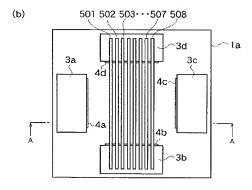




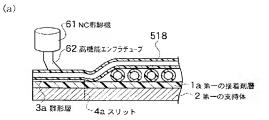
[図4]



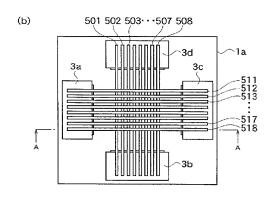
3a~3d: 離形層 4a~4d: スリット 501~508: 中空フィラメント(第一の中空フィラメント群)



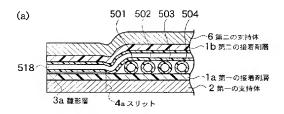
【図5】



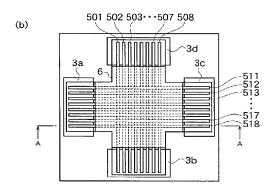
3a~3d: 離形層 4a~4d: スリット 501-508: 中空フィラメント(第一の中空フィラメント群) 511~518: 中空フィラメント(第二の中空フィラメント群)



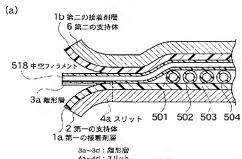
[図6]



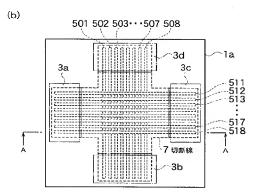
3a~3d:離形層 4a~4d:スリット 501~508:中空フィラメント(第一の中空フィラメント群) 511~518:中空フィラメント(第二の中空フィラメント群)



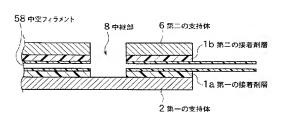
[図7]



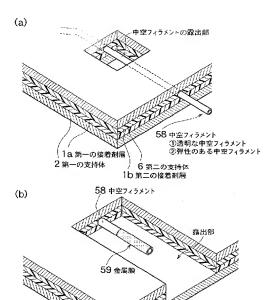
3a~3d:離形層 4a~4d:スリット 501~508:中空フィラメント(第一の中空フィラメント群) 511~518:中空フィラメント(第二の中空フィラメント群)



(a) 8 中継部 (a) 8 中継部 (b) 58 中空フィラメント (1a 第一の接着削層 2 第一の支持体 1b 第二の接着削層 1b 第二の接着削層 2 第一の支持体 1b 第二の接着削層



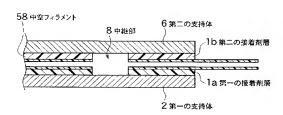
【図9】

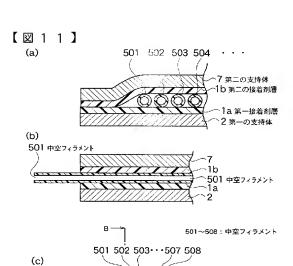


層) 6 第二の支持体 1b 第二の接着削層



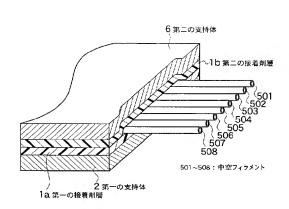
(b)

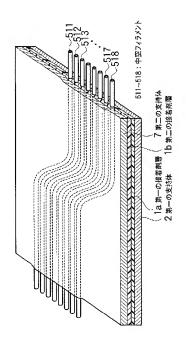




1a第一の接着剤層) 2第1の支持体 1b

【図 1 2】 【図13】





フロントページの続き

(74)代理人 100101247

弁理士 高橋 俊一

(74)代理人 100098327

弁理士 高松 俊雄

(72)発明者 河添 宏

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社総合研究所内

(72)発明者 中祖 昭士

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社総合研究所内

(72)発明者 有家 茂晴

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社総合研究所内

F ターム(参考) 4G075 AA02 AA89 BA10 BB10 DA02 EB22 EB27 EE21 FA01 FA12 FB02 FC04